

請求の範囲

- [請求項1] A l 又は A l 合金からなる芯線と、当該芯線の外周に A g、A u 又はそれらを含む合金からなる被覆層を有し、ワイヤ軸に垂直方向の芯材断面に対して結晶方位を測定した結果において、ワイヤ長手方向の結晶方位のうち、ワイヤ長手方向に対して角度差が 15° 以下である結晶方位 $\langle 111 \rangle$ の方位比率が 30～90%であることを特徴とするボンディングワイヤ。
- [請求項2] ワイヤの表面粗度が R_z で $2\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項1に記載のボンディングワイヤ。
- [請求項3] 前記被覆層の厚みが 1～100nmであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のボンディングワイヤ。
- [請求項4] ワイヤ線径が $50\sim600\mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項1～請求項3のいずれか1項に記載のボンディングワイヤ。